



SAMTEC 新製品リリース情報

製品名	COM-HPC® インターコネク ト ソリューション		
概 要	<p>PICMG コンソーシアムにて標準化された、次世代高性能コンピュータ・オン・モジュール (COM-HPC®) 規格に準拠した高密度インターコネクション・システム・コネクタ。</p> <p>AcceleRate® APF6/APM6 シリーズをベースとした製品が、COM-HPC® の標準化コネクタ (1ペアにて2列400ピンのコネクタを2ペアにて使用、合計800ピン) として採用されました。今後の組み込みシステムに要求される高速信号とその拡張性に対応したベストソリューションを提供します。</p>		
特 長	<ul style="list-style-type: none"> ● 1ch 当たり 32Gbps までの伝送速度 ● 最大 4096Gbps (1 平方インチ当たり 2088Gbps) ● PCIe®5.0 (32GT/s) をサポート ● 100Gb (4 x 25Gb) イーサネットをサポート ● BGA 実装 ● 実装時に反りを防止する為のフィクスチャー・ツールも準備あり 		
仕 様	<ul style="list-style-type: none"> ● 0.635mmピッチ、4列100ピン (合計400ピン) 列間ピッチ (1列2列間、3列4列間のピッチ: 2.2mm、2列3列間のピッチ: 2.4mm) ● 300W (11.4-12.6V時) まで印可電力 ● 型番 メス: ASP-209946-01 オス、スタック高さ5mm用: ASP-214802-01 オス、スタック高さ10mm用: ASP-209948-01 		
用 途	<ul style="list-style-type: none"> ● データコム、テレコム ● 組み込みシステム・サーバー ● 医療機器画像 ● 5G無線システム ● 5G車載機器 		
発売日	2021年 3月	価 格	弊社代理店より回答
製造発売元	<p>会 社 名: サムテック ジャパン エルエルシー 所 在 地: 横浜市港北区新横浜 3-8-8 日総第16ビル2F TEL: 045-475-1385 FAX: 045-475-1340 代表者名: 林 律雄</p>		
製品に関する お問い合わせ先	<p>(部署名/担当者氏名/連絡先) E-mail アドレス: japan@samtec.com</p>		

お問い合わせは下記まで。